

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約，亦不構成訂立協議以進行任何該等事項的邀請，且不屬收購、購買或認購任何證券的要約邀請。

本公告並非於美國(包括其領土和屬地、美國任何州份和哥倫比亞特區)出售證券的要約或邀請或其組成部分。本公告或其任何內容或其任何副本亦不得攜進美國境內或於美國境內直接或間接派發。除非本公告所述證券根據1933年美國證券法(經修訂)(「證券法」)登記或獲豁免遵守證券法或美國任何其他適用證券法律的登記規定，否則有關證券並無亦不會根據證券法或美國任何其他適用證券法律登記，且不得於美國提呈發售、出售或以其他方式轉讓。任何在美國提呈的證券公開發售必須由本公司刊發招股章程，當中須載列本公司及管理層以及財務報表的詳細資料。本公司無意在美國公開發售任何證券。



Shanghai Iluvatar CoreX Semiconductor Co., Ltd.

上海天數智芯半導體股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：9903)

**完成根據一般授權配售新H股
及
修訂公司章程**

整體協調人、聯席賬簿管理人及配售代理

Goldman Sachs 高盛

Morgan Stanley
摩根士丹利

 **华泰国际**
HUATAI INTERNATIONAL

(按字母順序)

被動聯席賬簿管理人及配售代理

J.P.Morgan
摩根大通

董事會欣然宣佈，配售協議項下的所有條件已獲達成，且配售已於2026年7月13日完成。合共14,857,000股新H股(分別佔緊隨配售完成後經配發及發行配售股份擴大後的已發行H股及已發行股份總數(不包括任何庫存股份)的約5.72%及約5.52%)已按照配售協議所載條款並在其條件規限下按配售價每股H股476.00港元成功配售予不少於六名承配人。

茲提述上海天數智芯半導體股份有限公司(「**本公司**」)日期為2026年7月9日的公告(「**該公告**」)，內容有關根據一般授權配售14,857,000股新H股。除另有說明外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

完成根據一般授權配售新H股

董事會欣然宣佈，配售協議項下的所有條件已獲達成，且配售已於2026年7月13日完成。

合共14,857,000股新H股(分別佔緊隨配售完成後經配發及發行配售股份擴大後的已發行H股及已發行股份總數(不包括任何庫存股份)的約5.72%及約5.52%)已按照配售協議所載條款並在其條件規限下按配售價每股H股476.00港元成功配售予不少於六名承配人。據董事於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，承配人及彼等各自的最終實益擁有人均為獨立第三方。概無承配人於緊隨配售完成後成為本公司主要股東(定義見上市規則)。

配售對本公司股權架構的影響

下表載列本公司緊接配售完成前及緊隨配售完成後的股權架構。

	緊接配售完成前		緊隨配售完成後 ⁽¹⁾	
	股份數目	佔已發行股份 總數概約 百分比 ⁽⁴⁾	股份數目	佔已發行股份 總數概約 百分比 ⁽⁴⁾
非上市股份	9,215,771	3.62%	9,215,771	3.42%
H股	245,101,965	96.38%	259,958,965	96.58%
核心關連人士	106,487,068	41.87%	106,487,068	39.56%
— 持股平台 ⁽²⁾	54,034,125	21.25%	54,034,125	20.07%
— 大鈺資本實體 ⁽³⁾	52,452,943	20.62%	52,452,943	19.49%
承配人	—	—	14,857,000	5.52%
其他公眾H股股東	138,614,897	54.50%	138,614,897	51.50%
合計	254,317,736	100.00%	269,174,736	100.00%

附註：

- (1) 該計算乃基於本公司於配售完成後及於本公告日期的已發行股份總數，即269,174,736股，其中包括9,215,771股非上市股份及259,958,965股H股。
- (2) 上海數麒是各持股平台的普通合夥人，因此根據證券及期貨條例，被視為於該等持股平台持有的合共54,034,125股H股中擁有權益。本公司執行董事、董事會主席兼首席執行官蓋魯江先生為上海數麒的唯一股東及唯一董事，因此根據證券及期貨條例，被視為於各持股平台所持有的H股中擁有權益。
- (3) 此數額為以下各項的總和：(i)大鈺一期投資基金直接持有的18,269,383股H股；(ii)南京優昀直接持有的16,503,313股H股；(iii) Masterwork Holdings直接持有的11,726,485股H股；以及(iv)廈門鈺美直接持有的5,953,762股H股。
- (4) 百分比已四捨五入至最接近的小數點後兩位，表中所列總額與金額總和之間的任何差異均為四捨五入所致。

有關配售理由及裨益及配售所得款項用途的補充資料

配售所得款項總額及所得款項淨額(扣除佣金及估計開支後)分別為約7,071.9百萬港元及約7,033.5百萬港元。

配售所得款項淨額擬用於以下用途：(i)60%將用於關鍵材料及零部件的戰略性供應鏈韌性及採購規劃；(ii)15%將用於加速現有產品的產品迭代及工程驗證，以及加快推進下一代產品的研發及商業化進程；(iii)10%將用於提升全棧軟件平台、模型適配及開發者生態系統，並在重點行業擴展基於特定場景的AI算力解決方案；(iv)10%將用於選擇性戰略投資及收購；及(v)5%將用於營運資金及一般企業用途。更多詳情請參閱該公告。

上市時，本公司根據其當時對產品研發、軟件棧開發、銷售及營銷、營運資金及一般企業用途相關動用期間的預期，制定其全球發售所得款項用途。自本公司於2026年初上市以來，AI行業迅速發展，尤其是token消耗量及對大規模AI訓練及推理集群的需求顯著增長，導致客戶需求及交付壓力達到本公司上市過程中前所未有的水平。該等AI集群需要遠高於傳統服務器的內存容量及頻寬，這個因素已推動對內存產品及相關關鍵部件的更強勁需求，導致相關供應短缺及價格波動。與此同時，超大規模服務供應商等主要市場參與者一直尋求透過較長期的安排確保產能，使可供應予更廣泛市場的產能減少，並進一步加劇內存產品及其他關鍵部件的短缺情況。與上市時的情況相比，本公司供應商及製造商越來越要求更早的採購規劃、長期安排及庫存緩衝，而本公司客戶現時更著重本公司供應鏈韌性、採購規劃，以及用於GPGPU加速器及AI算力系統的關鍵部件(包括內存產品及封裝相關部件)產能保證的能力。這過去六個月供需動態的轉變是本公司上市後最重大的行業發展，而進行配售的主要原因是為及時確保供應鏈韌性提供更多資金，而毋須將全球發售的餘下所得款項轉作其他非原定用途。這些發展上市時未能完全預測，而配售是一項滿足該等上市後新增要求的及時融資措施。餘下全球發售所得款項及現有現金資源不足

以撥付本公司擴展後的業務計劃，因為主要的新增資金需求是由供應鏈產能保證而非單純日常研發開支所引起。動用該等餘下全球發售所得款項撥付新識別的採購及產能鎖定需求將會減少本公司基線研發、軟件開發及商業化計劃可用的資金。

配售所得款項亦會支持目前市場發展所需的更具時效性且更貼近客戶需求的產品及軟件計劃，這些計劃有別於上市階段預期的較長期產品研發及專有軟件棧開發路線圖。產品方面，本公司擬應對上市後因AI部署快速演變而產生的產品開發及架構優化需求，包括從傳統服務器級解決方案向更為整合的集群級運算架構的轉變，而這帶來單個AI集群內更高運算效率、通訊效率及系統可管理性的新的產品要求。機架級超節點產品市場於本公司上市後逐漸成為一項重要的商業機會，而非上市時存在或可識別的機遇。因此，本公司擬加速機架級超節點產品及相關架構升級，包括全機架整合系統設計、高速互連、系統級供電與散熱，以及軟硬件協同優化。具體而言，機架級超節點產品要求本公司開發新的互連解決方案及交換系統，以支援高頻寬、低延遲及可擴展的節點間通訊，並採用更緊湊及高度集成的板卡設計形態。本公司亦須開發更穩定可靠的供電解決方案及更高效的散熱系統，以應對全機架系統不斷增加的功率密度，並確保穩定、長時間的高負載運作。此外，隨著AI集群互連架構、交換芯片、擴展網絡及機架級互連協議持續快速演進，本公司需要不斷評估相關協議、拓撲架構、頻寬演進、生態系統成熟度及實施成本，以使其機架級超節點產品能夠平衡技術先進性、商業可行性及長期可擴展性。此等工作範疇與上市階段預期的芯片級及加速器級研發存在實質性差異。此外，本公司於2026年2月推出彤央系列端側算力產品。該產品系列通過整合CPU及GPU算力資源與各類高速接口，將雲端架構的多運算整合及高並發推理能力延伸至邊緣應用場景。配售所得款項亦將有助加快本公司於上市後推出的其他產品（涵蓋大規模集群及邊緣AI部署場景，有別於本公司於招股章程披露的當時及下一代GPGPU芯片及加速器產品的一

般研發路線圖)的升級及技術迭代。軟件方面，本公司擬進一步提升商業化及客戶部署所需的軟件功能。配售所得款項擬用於應對上市後AI原生應用程式、token消耗量及大規模AI部署需求迅速增長產生的更具時效性且更貼近客戶需求的軟件要求。具體而言，由於本公司開發機架級超節點產品並支援更大規模的AI集群，這需要進一步提升諸如以下方面的軟件能力：營運及維護、通訊演算法、拓撲發現、系統監察、故障偵測、故障診斷及自動恢復，以及針對實際業務工作負載的系統級效率調優。配售所得款項亦將支持更廣泛的生態系統及商業化計劃，包括開發者工具、技術文件、開源社群發展、開發者關係管理、框架及模型適配，以及新興代理式AI工作負載的性能優化，這些計劃旨在改善部署品質、開發者採用率、客戶體驗以及在實際AI工作負載下的表現，因此超出上市階段預期的基礎軟件棧研發範圍。

有關配售所得款項中分配作營運資金及一般企業用途的部分，即約351.7百萬港元，其中約90%預期將用於僱員薪酬及福利，而餘下約10%預期將用於日常資訊科技營運及維護，以及支援本集團擴大營運及商業化活動所需的行政開支。

修訂公司章程

根據中國公司法及公司章程規定及於年度股東會上通過有關一般授權的決議案，董事會將對公司章程作出其認為適當的相應修訂，以反映根據一般授權發行額外股份導致的本公司註冊資本及總股本變動。

由於配售已於2026年7月13日完成，本公司的註冊資本及股份總數分別變更為人民幣269,174,736元及269,174,736股股份。為反映本公司註冊資本及總股本的該等變動，董事會已對公司章程作出相應修訂。

有關修訂公司章程的工商登記、備案及其他事宜將於中國相關政府或監管部門完成。經修訂公司章程全文可於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.iluvatar.com)查閱。

承董事會命
上海天數智芯半導體股份有限公司
董事會主席
蓋魯江先生

香港，2026年7月13日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事蓋魯江先生、孫怡樂先生、劉崢先生及楊磊先生；非執行董事王晨先生及丁俊博先生；及獨立非執行董事滕勇博士、任今濤先生及王燕博士。